

2021年中国集成电路设计行业分析报告- 产业竞争格局与发展潜力预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争格局与发展潜力预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/548993548993.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、集成电路设计行业产业链上游

1, 集成电路设计行业产业链上游现状

集成电路设计行业上游主要包括晶圆等电子材料生产行业和委外封测等加工行业。

晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称晶圆。数据显示，2016年中国晶圆制造行业市场规模突破1000亿元，预计2021年，我国晶圆制造行业市场规模或达到2941.4亿元。

2016-2021年我国晶圆制造市场规模 数据来源：观研天下整理

数据显示，全球硅晶圆片的价格受2008金融危机影响，呈下滑趋势，在2016年达到低谷。2016年开始晶圆价格逐步复苏。从2016年的0.67美元/平方英寸到2019年的0.95美元/平方英寸。

2010-2019年晶圆平均价格走向 数据来源：观研天下整理

2, 我国集成电路设计行业产业链上游代表企业

目前我国集成电路设计行业产业链上游代表企业包括联华电子股份有限公司、中芯国际、沪硅产业、天水华天科技股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司和通富微电。

我国集成电路设计行业产业链上游代表企业优势分析

类型

企业

优势分析

晶圆

联华电子

市场优势：是半导体晶圆制造业的领导者联电在全球约有12,000名员工，在台湾、日本、新加坡、欧洲及美国均设有服务据点，以满足全球客户的需求。

技术优势：持续推出先进制程技术并且拥有半导体业界为数最多的专利。联电完整的解决方案能让芯片设计公司利用尖端制程的优势,包括28纳米Poly-SiON技术、High-K/Metal Gate后闸极技术、14纳米量产、超低功耗且专为物联网(IoT)应用设计的制程平台以及具汽车行业最高评级的AEC-Q100 Grade-0制造能力,用于生产汽车中的IC。

中芯国际

产业链优势：在国际化管理理念的指引下,公司高度重视供应链的安全,与集成电路产业链的上下游企业建立了紧密的战略合作关系。公司近年来积极提升全产业链整合与布局的能力,通过与上下游企业合作,构建紧密的集成电路产业生态,为客户提供全方位、一体化的集成电路解决方案。

品牌优势：公司是中国大陆较早进入集成电路晶圆代工领域的企业,20年来长期专注于集成电路工艺技术的开发,曾荣获中国电子工业标准化技术协会“电子信息行业社会责任试点示范企业”、中国电子信息行业联合会“中国电子信息百强企业”、中国工业经济联合会“第四届工业大奖”、国家知识产权局“2018年度中国专利奖优秀奖”等60余项境内外荣誉奖项

沪硅产业

人才优势：公司鼓励创新和研发工作,高度重视技术研发团队建设。公司自设立以来持续引进全球半导体行业高端人才,经过多年的积累,公司拥有了一支国际化、专业化的管理和技术研发团队。目前公司已形成了以李炜博士、WANGQINGYU博士、AtteHaapalinna博士为核心的国际化技术研发团队。截至2019年9月30日,公司技术研发人员423人。公司主要研发人员具有较强的自主研发和创新能力,专业领域涵盖电子、材料、物理、化学等众多学科

技术研发优势：公司主要产品为300mm及以下的半导体硅片,经过多年的持续研发和生产实践,公司形成了深厚的技术积累。公司目前掌握了直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延、SIMOX、Bonding、Simbond、SmartCut™生产技术等半导体硅片制造的关键技术。

封测

天水华天科技

技术优势：近几年来,公司不断加强先进封装技术和产品的研发力度,加大研发投入,完善以华天西安为主体的仿真平台建设,依托公司现有的研发机构,通过实施国家科技重大专项02专项等科技创新项目以及新产品、新技术、新工艺的不断研究开发,自主研发出FC、Bumping、MEMS、指纹识别、MCM(MCP)、WLCSP、SiP、TSV等多项集成电路先进封装技术和产品,未来随着公司进一步加大技术创新力度,公司的技术竞争优势将不断提升。

成本优势：通过持续不断的工艺升级和技术改造,在扩大规模产业规模的同时有效提升了公司的生产效益、降低了生产成本,进一步强化了公司的成本竞争优势;天水基地具有较低的人力资源成本,土地使用、生产动力等方面的价格也相对较低,具有国外以及国内沿海地区集成电路封装企业所无法比拟的成本优势,随着公司集成电路封装规模的不断扩大以及成本管控的持续开展,公司在成本方面的竞争优势将进一步得到加强和巩固。

江苏长电科技

技术优势：长电科技在高端封装技术(如Fan-outeWLB、WLCSP、SiP、BUMP、PoP等)已与国际先进同行并行发展,在国内处于领先水平,并实现大规模生产。根据研究机构YoleDével

oppement报告,在先进封装晶圆份额方面,以全球市场份额排名:英特尔12.4%、矽品11.6%、长电科技7.8%位列第三。

研发优势:公司在中国和新加坡有两大研发中心,拥有“高密度集成电路封测国家工程实验室”、“博士后科研工作站”、“国家级企业技术中心”等研发平台;同时拥有经验丰富的研发团队。2017年度公司申请专利226件,其中已获受理专利193件。截至本报告期末,公司已获得专利3504件,其中发明专利2743件(在美国获得的专利为1758件),覆盖中高端封测领域。

通富微电

专利优势:作为国家高新技术企业,公司先后承担完成了多项国家级技术改造、科技攻关项目,取得丰硕技术创新成果;公司累计申报专利645件,累计拥有授权专利297件,其中授权发明11件,实用新型170件,美国发明专利授权16件。有了领先技术的支持,公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。

技术优势:公司目前封装技术水平及科技研发实力居于国内同业领先地位。公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台,拥有一支专业的研发队伍,并与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了长期合作关系,聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。资料来源:观研天下整理

二、集成电路设计行业产业链中游

1, 集成电路设计行业产业链中游现状

集成电路设计行业产业链中游包括电源和电池管理芯片行业和集成电路设计行业。

(1) 电源和电池管理芯片行业

电源管理芯片产品应用广泛,是全球出货量最大的芯片产品类型之一。根据统计数据,2019年全球电源管理芯片市场规模约为187亿美元,预计将于2024年增长至237亿美元,具有良好的市场发展前景。

2018年-2024年全球电源管理芯片市场规模 数据来源:观研天下整理

中国是全球最大的电子产品生产与消费国家,电源管理芯片市场需求巨大。根据统计数据,2019年我国电源管理芯片市场规模约为720亿元。

2012年-2019年中国电源管理芯片市场规模 数据来源:观研天下整理

(2) 集成电路设计行业

根据IC Insights统计数据，自2011年以来，随着全球电子信息产业的快速发展，全球集成电路设计业总体呈现持续增长的势头。2011年-2019年全球集成电路设计行业市场规模数据来源：IC Insights、观研天下整理

近年来随着我国集成电路设计业的持续快速发展，中国集成电路设计业在全球集成电路设计市场中的比重越来越高，已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动市场。

根据中国半导体行业协会统计数据，2011年-2020年中国集成电路设计业的销售收入由474亿元增长至3,778亿元，2020年同比增长23%。

2011年-2020年中国集成电路设计行业市场规模 数据来源：中国半导体行业协会
2，集成电路设计行业产业链中游代表企业

现阶段，我国集成电路设计行业产业链中游代表企业包括中颖电子股份有限公司、比亚迪半导体有限公司、思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司、圣邦微电子（北京）股份有限公司和广东赛微电子股份有限公司。国外集成电路设计行业产业链中游代表企业主要有德州仪器和凹凸科技。

集成电路设计行业产业链中游代表企业优势分析

企业

优势分析

国内

中颖电子股份有限公司

客户优势：有别于欧、美、日大型IC设计企业采用的通用MCU的经营方式,公司秉承本土化、差异化的经营理念,强调贴近客户,深刻理解专业应用领域用户的需求,开发出有差异化的创新产品,在细分领域中力争把产品的功能、质量、成本等方面做到最优,从而取得竞争优势。公司与国内诸多一线品牌大厂建立了长期、稳定的合作关系,可以为客户提供完备的软硬件一体化服务,包括整体方案开发、嵌入式固件开发及外围硬件电路的设计等,显著降低了客户成本及研发周期,强化了与客户取得双赢的伙伴关系。

研发优势：公司新产品的开发逐步展现高端化、复杂化趋向,更多的新产品采用32位元内核,一些产品线对制程的要求也不断提高,部分产品由8寸晶圆生产转向12寸晶圆生产。由于单项产品开发投入的规模不断加大,公司持续深化研发管理,争取有效降低研发风险。

比亚迪半导体有限公司

综合领域优势：在动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元

电池,分别应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。目前,集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。

技术优势: 凭借于汽车、IT、新能源三大领域积累的综合技术优势,比亚迪耗时5年研发出全新设计的跨座式单轨“云轨”产品,并于2016年10月发布了中国首条拥有自主知识产权的云轨线路并实现通车,正式宣告比亚迪进军城市轨道交通领域。比亚迪云轨通过配备的动力电池建立起能量回收系统,大幅降低了列车运行的能耗水平,通过配备轮边电机实现了各车厢的独立驱动,大幅提高了列车运行的安全水平。通过对上游核心部件如电力牵引和电力控制的垂直整合,比亚迪成功打造出云轨产品的品质优势和成本优势,以及长期可持续的核心竞争力。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

人才优势: 公司高度重视研发和管理人才的培养,积极引进国内外高端技术人才,目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至2019年12月31日,公司共有研发和技术人员98人,占全部员工人数的比重达62.82%,研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验;共有核心技术人员5人,领导并组建了由多名模拟芯片行业资深人员组成的技术专家团队,构成公司研发的中坚力量。

产品优势: 公司严格遵循JEDEC等国际通用标准建立了完备的品质保证体系,在新产品的设计验证阶段以及产品量产后的在线可靠性监控阶段均进行了全面、严格的可靠性考核,包括高温带电老化、高温高湿老化、高低温度循环、高温存储、静电放电和门锁保护等多达十余项检验测试。同时,公司选择国内外领先的晶圆厂和封测厂进行生产,在最大程度上确保委外环节的质量。

广东赛微电子股份有限公司

服务优势: 公司注重销售服务人员专业能力和客户响应效率,拥有一支经验丰富、专业技术过硬,客户响应及时的现场技术支持团队,能够高效快速解决前期导入时的问题,缩短产品导入时间。此外,公司市场及研发团队始终贴近国内市场需求,与行业顶尖客户保持长期良好的合作关系,随着合作深入,公司逐步融入众多战略客户的新产品研发体系中,有利于形成业务协同,培养合作默契和商业粘性

品牌优势: 公司自成立以来,长期专注于电池管理芯片领域,凭借在模拟集成电路设计和电池电化学领域长期研发,以及对于专业高效的销售和技术团队的建设,公司在客户中已形成“产品稳定可靠,服务及时高效”的特点。在电池管理芯片领域已树立良好的品牌形象及服务口碑,为开拓新市场、建立合作奠定了坚实的基础。

圣邦微电子(北京)股份有限公司

多样性优势: 在信号链和电源管理领域自主研发的可供销售产品超过800款,横向涵盖十多个产品类别,可满足客户的多元化需求。例如,公司的LED背光驱动器类系列产品有并联恒流型、电荷泵型、DC/DC升压型等,有共阴/共阳、4/6/8路并联、升压串联4/6/8/10颗LED灯等多种输出形式,有TSOT、DFN、TQFN等不同封装类型。

技术优势：公司已形成了多项核心技术,共拥有六十余项集成电路布图设计登记证书、二十余项已授权专利。公司拥有北京市科学技术委员会等四部门颁发的“高新技术企业证书”和工信部颁发的“集成电路设计企业认定证书”。2008年以来,公司连续多年获得《电子工程专辑》颁发的“十大中国IC设计公司品牌”奖。

国外

德州仪器公司

行业地位优势：是一家跨国性的半导体设计与制造公司。他们在30多个国家/地区拥有约30,000名员工,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。德州仪器是世界第一大数字信号处理器(DSP)和模拟电路元件制造商,其模拟和数字信号处理技术在全球具有统治地位。在连续收购飞索半导体制造部门、成都成芯半导体之后,2011年德州仪器收购美国国家半导体,进一步强化德仪的模拟半导体巨头地位。

业务范围优势：是一家全球性的半导体公司,主要从事设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片。TI的电源管理芯片包括全系列电源管理芯片产品,包括电池安全芯片、电池计量芯片和其他电源管理芯片,应用领域广泛。

凹凸科技

品牌优势：凹凸科技拥有全球领先的电源管理系统架构、快速的市场响应能力、牢固的客户关系以及强大的数模混合设计能力。凹凸科技拥有业内资深的设计、管理团队;分支机构遍布全球;有着多年的成功业绩。公司所有的芯片都在全球知名的芯片制造厂生产。凹凸科技非常重视知识产权的开发和保护,拥有广泛且大量的芯片和应用领域的国际发明专利,和为数众多的注册商标以及其他知识产权。资料来源：观研天下整理

三、集成电路设计行业产业链下游

1, 集成电路设计行业产业链下游现状

集成电路设计行业产业链下游包括锂离子电池、电动工具、轻型电动车辆、智能手机等。

(1) 锂离子电池

根据国家统计局数据,2015-2020年中国锂离子电池产量从56亿只增长到188亿只,年均复合增长率约为27%,持续保持高速增长。 2015-2020我国锂离子电池产量

数据来源：国家统计局

(2) 电动工具

根据Allied Market Research统计数据,2020年全球电动工具市场的市场规模约221亿

美元，预计2027年将达到391亿美元，2020-2027年的年均复合增长率将超过8%。
2020年-2027年全球电动工具市场规模预测 数据来源：Allied Market Research

(3) 电动车辆

中国是全球新能源汽车增速较快的地区市场，根据统计数据，预计到2020年-2027年中国电动及混动汽车市场规模将由562亿美元增长至1,809亿美元，年均复合增长率将超过18%。2019年-2027年中国电动及混动汽车市场规模 数据来源：观研天下整理

(4) 智能手机

随着手机模块以及功能的复杂化，单部手机的电池管理芯片数量呈现出增长的趋势，高端智能手机在电量计、电池保护、充电管理等方面对电池管理芯片的需求持续上升，平均每部智能手机所需芯片数量达到4颗以上。2021年，全球智能手机产业可望随着日趋稳定的生活型态而回温，通过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至13.6亿支，年增长9%。

2016-2021年全球智能手机产量 数据来源：观研天下整理

2，我国集成电路设计行业产业链下游代表企业

现阶段，我国集成电路设计行业产业链下游代表企业包括孚能科技、电能股份、星源材质、锐奇股份、康平科技、比亚迪、北汽蓝谷、立讯精密和华为等。

集成电路设计行业产业链下游代表企业优势分析

类型

企业

优势分析

锂离子电池

孚能科技

技术路线优势:中国第一批量产三元软包动力电池企业，公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一,是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。三元软包动力电池具备高能量密度、高安全性能、循环寿命长的重要优势,符合动力电池的技术发展方向。公司的核心团队已经在三元软包动力电池的研发、生产及应用等方面积累了丰富的经验,因而,公司在三元软包动力电池技术路径上具备先发优势。同时,公司始终保持对锂离子动力电池前沿研究领域的密切跟踪,能够把握产业发展趋势和技术革新方向。

客户资源优势:配套多款销量领先车型,具备国内外龙头车企客户资源。下游整车企业对于动力电池企业具有重要的意义,下游整车企业的品牌影响力和资金实力,将直接决定动力电池企

业的产品销量和回款情况。凭借技术优势、产品优势等,公司产品可覆盖配套多种新能源乘用车,拥有优质的客户资源。主要客户:北汽新能源、戴姆勒、北京奔驰。公司其他客户包括广汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安等国内知名整车企业,同时正在拓展大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞、东风等国内外一线整车企业客户

电能股份

研发团队优势:拥有的研发团队、在空间储能专项科技攻关、航天储能电池产品研制和技术服务上具有较为丰富的经验,核心研发人员长期保持稳定。力神特电团队主持和参与起草了多项特种锂离子电池领域的国家标准。核心研发团队和关键技术人员保持稳定,并逐步扩大团队规模。

技术优势:是国内从事空间锂离子蓄电池研究工作的单位,一直致力于锂离子电池的研发设计、生产制造和测试分析的研究工作,承担了多个重点科研项目,获得奖项十余项,在锂离子电池设计、制造上获得多项专利授权,承担了多个能源专项科研任务。公司两家子公司一直重视技术开发和创新,先后承担特种锂离子电源方面重点科研项目数十项,现已在通信电池、AGV电源等领域形成技术优势。

星源材质

市场优势:锂离子电池隔膜是锂离子电池厂商的关键内层组成部件之一,隔膜的一致性、稳定性和安全性直接影响锂离子电池的产品性能、产品质量和生产成本。鉴于隔膜在锂离子电池安全性方面的重要性,再加上锂离子电池生产线投资较大,下游锂离子电池厂商在选择隔膜时会对隔膜供应商进行较长时间的考察,经认可后通常会建立稳定的长期业务合作关系。

研发优势:公司建立了行业领先的研发平台,近年来,公司一直保持与国外先进企业的紧密联系,在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上,始终专注于自主研发设备投入和相关平台建设;公司建立了行业领先的研发团队和研发机制,公司一直以来高度重视锂离子电池隔膜的研究和开发专业队伍的建设,设立专门的技术委员会负责对公司产品技术的发展方向和相关研发项目进行技术评审,是引导公司整体科研发展方向的最高机构。

电动工具

锐奇股份

技术优势:作为中国电动工具行业高新技术企业,公司坚持自主创新,高度重视新技术、新产品的研发,拥有多项核心技术和众多授权专利。公司长期致力于专业电动工具相关技术的研究和开发,积累了丰富的研发经验,对各应用行业客户的需求有着深入的了解,能够紧密结合客户特点和市场特点研发产品。通过不断的技术创新,公司将不断满足客户对于高效能专业电动工具的需求。公司在长期产品开发中积累并加强了自身研发实力,吸引了众多国际品牌电动工具运营商的主动技术合作。产品的成功研发和投产,不但给公司业绩提供了有力帮助,同时也巩固并提高了公司在这些产品技术领域的领先优势。

品牌优势:公司始终坚持自主品牌战略,准确定位于“替代进口工具的品牌”,以产品品质和售后服务为依托,在消费者群体中建立了良好的品牌美誉度、信任度和忠诚度。公司上市后,企

业影响力、品牌形象和产品的品牌附加值进一步得到提升。依托已建立的品牌形象,公司不仅能够很好地开拓高效能专业电动工具市场,对进口工具实现替代,而且能够向附件及相关领域拓展,在市场开拓过程中形成良好的品牌效应。

康平科技

供应链优势：基于在电机制造业的长期耕耘以及庞大的生产规模,公司已经在电机零部件采购领域积累了较为丰富的供应商渠道和采购经验。公司不仅能够根据客户订单要求迅速组织采购,在众多供应商中选取性价比更高、响应速度更快、交期更加及时的供应商,极大地提高供应链管理能力和原料采购效率,另一方面,公司还可以协助下游整机厂商优化供应商结构,进而提升电动工具产业链的整体协作效率。

技术优势：公司目前已掌握了电动工具用电机的核心工艺技术,在绕线、点焊、滴漆、动平衡、精车及自动检测上运用了先进的设备以及完善的工艺技术管控,工艺控制已达到较高水平,并获得了主流电动工具厂商的一致认可。特别是公司技术人员在铜铝焊接工艺方面取得技术突破,使铜铝导线的焊接质量得到很大提高,扩大了铝线在电动工具用电机上的应用范围,也推动了采用铝线(定子绕组)的电动工具得到3C认证。

电动汽车

比亚迪

综合技术优势：凭借于汽车、IT、新能源三大领域积累的综合技术优势,比亚迪耗时5年研发出全新设计的跨座式单轨“云轨”产品,并于2016年10月发布了中国首条拥有自主知识产权的云轨线路并实现通车,正式宣告比亚迪进军城市轨道交通领域。比亚迪云轨通过配备的动力电池建立起能量回收系统,大幅降低了列车运行的能耗水平,通过配备轮边电机实现了各车厢的独立驱动,大幅提高了列车运行的安全水平。通过对上游核心部件如电力牵引和电力控制的垂直整合,比亚迪成功打造出云轨产品的品质优势和成本优势,以及长期可持续的核心竞争力。

全球新能源汽车产业的领跑优势：比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力,已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术,建立起于新能源汽车领域的全球领先优势。比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团,拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术,以及全球首创的双模二代技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,为全球汽车产业开拓出崭新的发展路径。

北汽蓝谷

研发优势：北汽新能源将研发能力作为企业的核心竞争力,加大研发投入,构建了完整的面向未来的新一代新能源整车研发体系,提升了电池电机电控、智能网联、智能驾驶、新材料、换电储能等领域核心竞争能力。平台开发能力,引领高端制造:伴随着新能源汽车三电及智能技术不断积累提升,北汽新能源产品开发经历了单品“油改电”阶段、单品设计开发阶段,现已进入高性能整车模块化平台开发阶段。已建立满足新产品研发特点的整车开发管理流程,保证了新车开发进度、质量、成本、目标的要求,有效控制风险。目前已构建“大、中、小”三大

类全新平台搭建,涵盖A00级到B级,轿车、SUV、CROSSOVER等多级别跨车型全面产品类型,平台底盘架构化设计,衍生多款底盘拓展方案,凸显平台车型研发周期短、开发费用相对较低、通用化率高等优势。

市场优势：北汽蓝谷子公司北京新能源汽车股份有限公司创立于2009年,是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业。北汽新能源从节能环保到电动化、智能化、网联化、共享化为目标的发展过程中实现了三年打基础、三年上水平、三年上规模的各阶段发展目标,自2013年以来连续七年保持国内新能源纯电动乘用车的销量第一。

智能手机

立讯精密

团队优势：人才,永远是公司的第一资源,更是企业发展的核心要素。公司的经营管理团队多年来深耕连接线、连接器行业,不仅具有丰富的管理经验,同时具有不断进取的开拓精神和强烈的责任心与使命感,这些优势让我们能够敏锐感知客户和市场的变化并做出迅速反应。近年来,公司在新、旧领域不断扩张同时积极开拓国际市场,而随着具有专业领域背景的国际化管理和技术创新人才的不断加入,为公司的高速持续发展提供了良好的人力资源保障。

技术优势：公司始终坚持以技术发展为导向,不断加大研发投入,公司历年在研发上的投入呈现上升趋势,其中2015年全年投入研发费用5.82亿元,较2014年度增加44.06%。2015年度,公司新申请专利225项,取得专利授权185项,截至2015年底,公司在海内外共取得各项专利700余项。通过不断地技术创新,既满足了客户多方面的需求,也实现自身的快速发展。由此可见,技术创新已成为公司竞争优势。

华为

规模优势：在运营商业领域，华为的4G设备在全球被广泛部署，已进入140多个国家的首都；华为发布了4.5G解决方案，保护4G投资的同时，满足消费者不断提升体验的需求。华为承建了全球280多个400G核心路由器商用网络。华为通过实施产品与服务双驱动战略，支撑着全球1,500多张网络的运营，覆盖了170多个国家，服务全球超过三分之一的人口，越来越多的运营商视华为为其可信赖的战略合作伙伴。华为云计算的企业级合作伙伴达500多家，服务于全球108个国家和地区的2,500多家客户，覆盖政府及公共事业、运营商、能源、金融等行业，部署超过140万台虚拟机。在全球部署660个数据中心，其中255个为云数据中心。

品牌优势：华为是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于实现未来信息社会、构建更美好的全联接世界。得益于中高端产品、海外高端市场和荣耀模式的长足发展，年销售收入增长超70%，市场份额稳居全球TOP3阵营。继Mate 7、P7等精品智能手机的成功，P8、Mate 8进一步夯实中高端地位；荣耀品牌以亲和力与活力正联接起更多的消费者，收入翻番。

资料来源：观研天下整理（LM）

观研报告网发布的《2021年中国集成电路设计行业分析报告-产业竞争格局与发展潜力预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2017-2021年中国集成电路设计行业发展概述

第一节 集成电路设计行业发展情况概述

- 一、集成电路设计行业相关定义
- 二、集成电路设计行业基本情况介绍
- 三、集成电路设计行业发展特点分析
- 四、集成电路设计行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式

五、集成电路设计行业需求主体分析

第二节 中国集成电路设计行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、集成电路设计行业产业链条分析

三、产业链运行机制

(1) 沟通协调机制

(2) 风险分配机制

(3) 竞争协调机制

四、中国集成电路设计行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国集成电路设计行业生命周期分析

一、集成电路设计行业生命周期理论概述

二、集成电路设计行业所属的生命周期分析

第四节 集成电路设计行业经济指标分析

一、集成电路设计行业的赢利性分析

二、集成电路设计行业的经济周期分析

三、集成电路设计行业附加值的提升空间分析

第五节 中国集成电路设计行业进入壁垒分析

一、集成电路设计行业资金壁垒分析

二、集成电路设计行业技术壁垒分析

三、集成电路设计行业人才壁垒分析

四、集成电路设计行业品牌壁垒分析

五、集成电路设计行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球集成电路设计行业市场发展现状分析

第一节 全球集成电路设计行业发展历程回顾

第二节 全球集成电路设计行业市场区域分布情况

第三节 亚洲集成电路设计行业地区市场分析

一、亚洲集成电路设计行业市场现状分析

二、亚洲集成电路设计行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲集成电路设计行业市场前景分析

第四节 北美集成电路设计行业地区市场分析

一、北美集成电路设计行业市场现状分析

二、北美集成电路设计行业市场规模与市场需求分析

三、北美集成电路设计行业市场前景分析

第五节 欧洲集成电路设计行业地区市场分析

一、欧洲集成电路设计行业市场现状分析

二、欧洲集成电路设计行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲集成电路设计行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界集成电路设计行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球集成电路设计行业市场规模预测

第三章 中国集成电路设计产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品集成电路设计总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国集成电路设计行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国集成电路设计产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国集成电路设计行业运行情况

第一节 中国集成电路设计行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国集成电路设计行业市场规模分析

第三节 中国集成电路设计行业供应情况分析

第四节 中国集成电路设计行业需求情况分析

第五节 我国集成电路设计行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国集成电路设计行业供需平衡分析

第七节 中国集成电路设计行业发展趋势分析

第五章 中国集成电路设计所属行业运行数据监测

第一节 中国集成电路设计所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国集成电路设计所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国集成电路设计所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国集成电路设计市场格局分析

第一节 中国集成电路设计行业竞争现状分析

一、中国集成电路设计行业竞争情况分析

二、中国集成电路设计行业主要品牌分析

第二节 中国集成电路设计行业集中度分析

一、中国集成电路设计行业市场集中度影响因素分析

二、中国集成电路设计行业市场集中度分析

第三节 中国集成电路设计行业存在的问题

第四节 中国集成电路设计行业解决问题的策略分析

第五节 中国集成电路设计行业钻石模型分析

- 一、生产要素
- 二、需求条件
- 三、支援与相关产业
- 四、企业战略、结构与竞争状态
- 五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国集成电路设计行业需求特点与动态分析

第一节 中国集成电路设计行业消费市场动态情况

第二节 中国集成电路设计行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 集成电路设计行业成本结构分析

第四节 集成电路设计行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

第五节 中国集成电路设计行业价格现状分析

第六节 中国集成电路设计行业平均价格走势预测

- 一、中国集成电路设计行业价格影响因素
- 二、中国集成电路设计行业平均价格走势预测
- 三、中国集成电路设计行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国集成电路设计行业区域市场现状分析

第一节 中国集成电路设计行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区集成电路设计市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区集成电路设计市场规模分析
- 四、华东地区集成电路设计市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述

- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区集成电路设计市场规模分析
- 四、华中地区集成电路设计市场规模预测
- 第四节 华南地区市场分析
 - 一、华南地区概述
 - 二、华南地区经济环境分析
 - 三、华南地区集成电路设计市场规模分析
 - 四、华南地区集成电路设计市场规模预测

第九章 2017-2021年中国集成电路设计行业竞争情况

第一节 中国集成电路设计行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国集成电路设计行业SCP分析

- 一、理论介绍
- 二、SCP范式
- 三、SCP分析框架

第三节 中国集成电路设计行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 集成电路设计行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国集成电路设计行业发展前景分析与预测

第一节 中国集成电路设计行业未来发展前景分析

一、集成电路设计行业国内投资环境分析

二、中国集成电路设计行业市场机会分析

三、中国集成电路设计行业投资增速预测

第二节 中国集成电路设计行业未来发展趋势预测

第三节 中国集成电路设计行业市场发展预测

一、中国集成电路设计行业市场规模预测

二、中国集成电路设计行业市场规模增速预测

三、中国集成电路设计行业产值规模预测

四、中国集成电路设计行业产值增速预测

五、中国集成电路设计行业供需情况预测

第四节 中国集成电路设计行业盈利走势预测

- 一、中国集成电路设计行业毛利润同比增速预测
- 二、中国集成电路设计行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国集成电路设计行业投资风险与营销分析

第一节 集成电路设计行业投资风险分析

- 一、集成电路设计行业政策风险分析
- 二、集成电路设计行业技术风险分析
- 三、集成电路设计行业竞争风险分析
- 四、集成电路设计行业其他风险分析

第二节 集成电路设计行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国集成电路设计行业发展战略及规划建议

第一节 中国集成电路设计行业品牌战略分析

- 一、集成电路设计企业品牌的重要性
- 二、集成电路设计企业实施品牌战略的意义
- 三、集成电路设计企业品牌的现状分析
- 四、集成电路设计企业的品牌战略
- 五、集成电路设计品牌战略管理的策略

第二节 中国集成电路设计行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国集成电路设计行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国集成电路设计行业发展策略及投资建议

第一节 中国集成电路设计行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国集成电路设计行业营销渠道策略

一、集成电路设计行业渠道选择策略

二、集成电路设计行业营销策略

第三节 中国集成电路设计行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国集成电路设计行业重点投资区域分析

二、中国集成电路设计行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/548993548993.html>